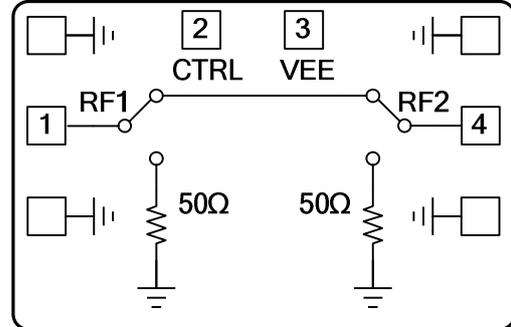




主要特点

- 内部集成TTL驱动
- 隔离度: 40 dB @ 50 GHz
- 插入损耗: 1.6 dB @ 50 GHz
- 匹配式设计
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.5 × 1 × 0.1 mm³

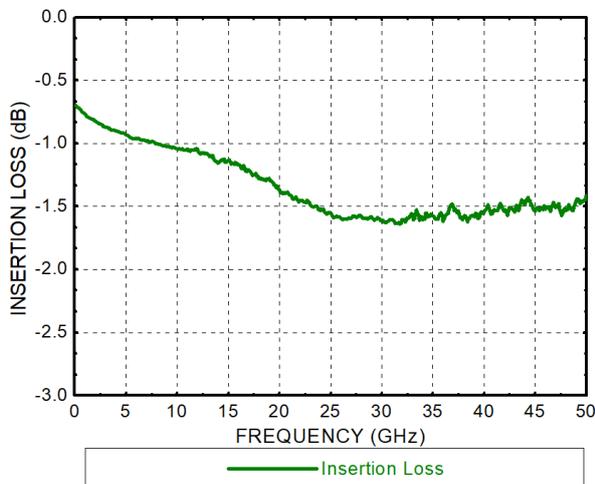
功能框图



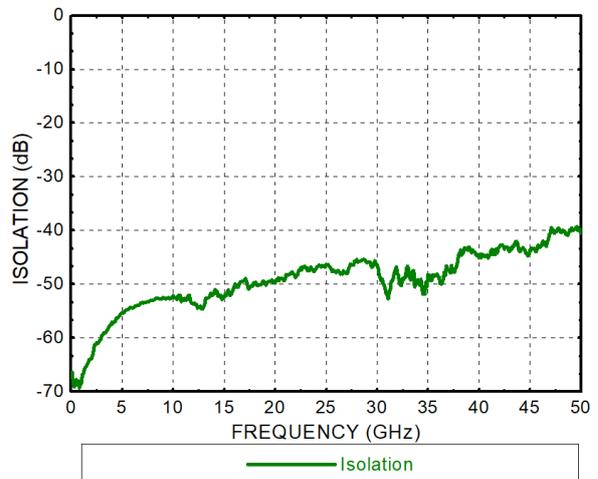
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$, $V_{CTRL} = 0/+5\text{V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 50			GHz
插入损耗		1.6		dB
隔离度		45		dB
回波损耗“打开状态”		18		dB
回波损耗“关闭状态”		15		dB
输入功率 1dB 压缩点@1-50GHz		22		dBm
开关切换时间		15		ns

插入损耗

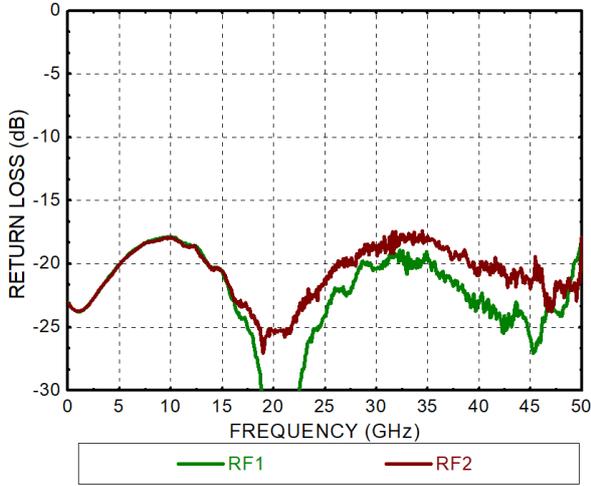


隔离度

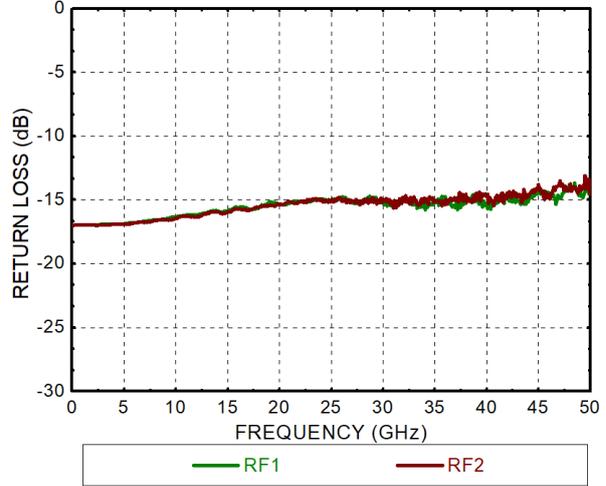




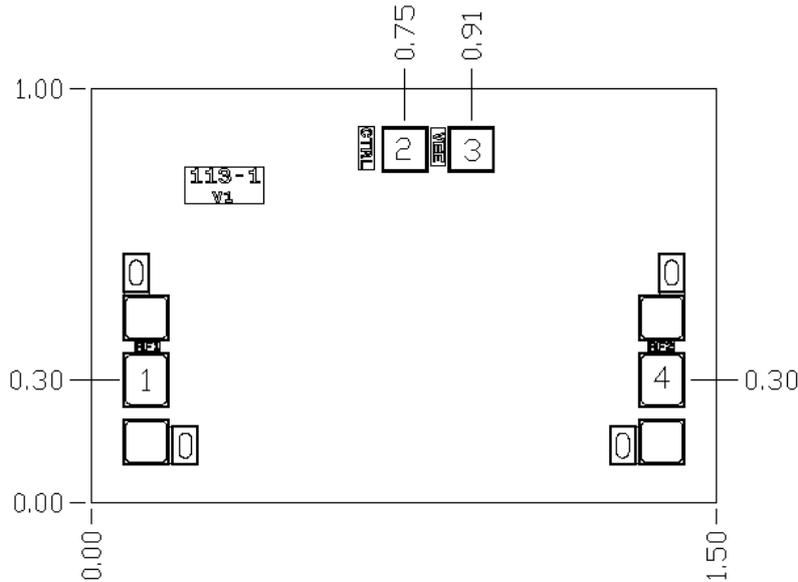
回波损耗, “ON” 状态



回波损耗, “OFF” 状态



物理参数



焊盘描述

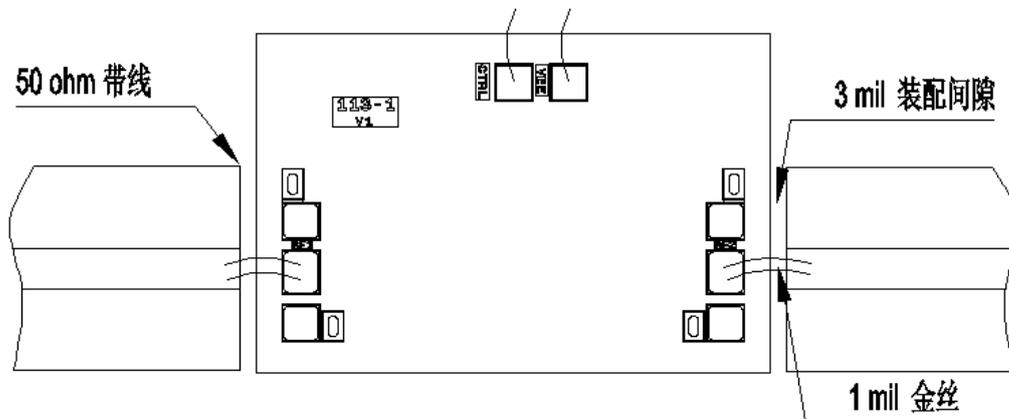
焊盘序号	功能	描述
1, 4	RF1, RF2	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
2	CTRL	CTRL=5V 则 RF1、RF2 为 “ON” 状态; CTRL=0V, 则为 “OFF” 状态
3	VEE	该焊盘为数字电路电源端, 接-5V 电源电压
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

功能	CTRL
ON	1
OFF	0
“0”电平范围：0~0.8V，“1”电平范围：2.3~5V。	

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100um
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100um²
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率：+27 dBm
2. 储存温度：-65~+150°C
3. 工作温度：-55~+85°C